元件布局原则

- 先大原件再小原件
- 尽量放在同一层
- 根据信号主流向安排主要原件
- 部分可采取对称式
- 总线和关键信号线短
- 高压,大电流与低压,小电流要分开
- 模拟与数字分开
- 高低频信号要分开
- 发热的原件均匀分布
- 温度敏感元件原理发热大的元件
- 元件排列要便于日后维修

元件布线原则

- 根据电流设计线宽和线长
- 不应该过细,最低10mil
- 拐弯处一般是135°圆角或钝角,不能走锐角,尽量不走直角
- 同一层导线方向一致
- 不同层导线尽量相互垂直
- 不同层导线连接必须过孔
- 先布要求高的线,再布要求低的线
- 地线铺铜

覆铜

- 一般把铜线接地作用:
- 1. 减小地线阻抗,提高抗干扰能力
- 2. 降低压降,提高电源利用效率
- 3. 减小环路面积
- 实心铺铜vs网格普通
- 1. 实心适合大电流,但过波峰焊会导致电路板变形
- 2. 网格对于高频电路效果好
- 模拟地和数字地要分开,单点连接
- 晶振周围要环绕铺铜
- 天线周围不能铺铜

图形符号和注释性字符

丝印摆放

- 丝印不能放在过孔,焊盘上(放不上)
- 一般放在元件旁边
- 丝印不应该放在元件下方,避免元件焊接后被遮挡

• 保持方向统一性,不要超过两个方向摆放,推荐在左在下

查看3D视图

• 检查有无元器件封装选择错误、 元器件位置摆放不当、 丝印位置摆放不当

注意事项

- usb,开关等放在pcb板边上,便于连接
- ISP是备用方案,表贴USB用不了的时候换备用ISP供电
- 收音机竖直放置,所以最下面不能放开关之类的不然立不起来
- 量喇叭尺寸画一个圆表示喇叭尺寸
- 同上,对于电池盒,同时使用胶水粘住
- 有两个元件放在背面,但也需要有一定支撑使得收音机可以躺着放
- 螺丝2.5mm, pcb的孔大小为2.5mm-3mm, 螺丝3mm, 孔为3-4mm
- 四个灯 ^ef01e5
 - o LED1:电源
 - LED2: RSSI 信号强度
 - LED3: 自定义LED4: 自定义
- 名字有特殊他要求
- 0欧电阻:可以焊接当成导线,也可以不焊接,电路断路,相当于可拆卸导线
- battery不做焊盘直接连接
- 电线焊盘处不铺铜,因为会吸收信号
- 先开孔,再连线
- 数码管上方的小孔(过孔)连接铜的两层,避免孤岛
- 连接焊盘处是有钝角的
- PCB做完后要进行DRC,检查结果在设计管理器中
- ISP中GND引脚在下边
- ![[Pasted image 20240522165306.png]]
- 红色加粗的线是电源线
- 下面为加粗的线,代表可能需要的线可能流过大电流!
- 不建议用黑色或者白色,因为看不出来

• 不需要生产稿